

2023.6.21 ニュースリリース

三次元実装およびファンアウト半導体パッケージ用 『ウエハハンドリングシステム』大口受注のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ヶ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、大手OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)企業からプロセス装置事業を譲り受けてはじめてとなるウエハハンドリングシステム装置の受注を致しましたので以下の通りご報告申し上げます。

微細化・集積化に対し各社競い合ってきましたが前工程のリソグラフィーは物理的な限界に近付いているため、後工程におけるパッケージ工程での開発が活発化しております。一方、5G、IoT向けサーバーや高性能コンピューター、自動運転市場の継続的な成長により高性能・超高速・低消費電力の要求は年々高まってきております。これら背景及びニーズが三次元実装(2.5Dおよび3D)およびファンアウト半導体パッケージ市場を大きく牽引しており、更なる薄化・積層化への要求および向上が求められております。

当社ウエハハンドリングシステム装置は薄化・積層化に対し重要なプロセスの一つを担っており、同時に安定した品質が要求されます。長年培ってきたウエハの仮接合及び薄化後のウエハからサポートガラスを剥し洗浄するプロセス技術と当社のモノづくり力との融合により、リードタイムにお応えできる高性能ウエハハンドリングシステム装置をご提案して参りました。

その結果、大手OSAT企業の複数社から高い評価を頂き大口の受注に至りました。現在、海外の企業を中心に多数の引合を受けております。高品質・高良品率へのニーズが高く、歩留り率向上を実現できる当社設備の採用が検討されております。

当社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/>